

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 关于投资建设士兰集昕二期项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 投资项目名称：士兰集昕二期项目
- 投资金额：项目总投资 15 亿元，其中：股东出资 8 亿元，通过金融机构融资解决约 7 亿元。
- 本次投资无需提交公司股东大会审议。

#### 一、投资概述

##### （一）投资的基本情况

##### 1、投资项目名称：士兰集昕二期项目

公司子公司杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）为公司 8 吋集成电路芯片生产线（以下简称“8 吋线”）的运行主体。士兰集昕 8 吋线于 2017 年 6 月底正式投产，产出逐步增加，2018 年总计产出芯片 29.86 万片。目前已有高压集成电路、高压 MOS 管、低压 MOS 管、肖特基管、IGBT 等多个产品导入量产。8 吋线持续上量对公司的整体营收增长起了积极推动作用。为进一步提高芯片产出能力，提升制造工艺水平，士兰集昕拟对 8 吋线进行技术改造。本项目利用士兰集昕现有的公用设施，在现有生产线的基础上，通过增加生产设备及配套设备设施，形成新增年产 43.2 万片 8 英寸芯片制造能力。

2、项目投资：本项目总投资 15 亿元，建设周期约为五年，分两期进行。其中，一期计划投资 6 亿元，形成年产 18 万片 8 英寸芯片的产能。二期计划投资 9 亿元，形成年产 25.2 万片 8 英寸芯片的产能。

3、资金的来源：本项目的总投资约 15 亿元，其中股东出资约 8 亿元，其余资金通过向金融机构融资解决。士兰集昕本次拟新增注册资本 702,983,849 元，公司和国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）本次拟以货币方式共同出资 8 亿元认购士兰集昕新增的全部注册资本。其中本公司出资

3 亿元人民币，大基金出资 5 亿元人民币，具体投资方式见本公告“二、投资方式及投资各方的基本情况”部分。本次增资完成后士兰集昕的注册资本将由 1,259,395,563 元增加至 1,962,379,412 元。本次出资溢价部分将计入士兰集昕的资本公积。

(二) 公司于 2019 年 8 月 26 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设士兰集昕二期项目的议案》，同时董事会批准并授权董事长陈向东先生签订与本次投资有关的协议。

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，本次对外投资金额未达到公司最近一期经审计后总资产的 30%，在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

(三) 本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资方式及投资各方的基本情况

### (一) 投资方式

#### 1、增资集华投资

大基金出资 3 亿元人民币，本公司出资 3.15 亿元人民币，共同增资杭州集华投资有限公司（以下简称“集华投资”），出资方式均为货币。本次增资无溢价。共同增资后集华投资的注册资本将增加至 102,500 万元人民币。

增资完成后，集华投资的股权结构如下所示：

股东名称	增资完成前的持股比例	增资完成前的出资额（万元）	增资完成后的持股比例	增资完成后的出资额（万元）
杭州士兰微电子股份有限公司	51.22%	21,000	51.22%	52,500
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	48.78%	20,000	48.78%	50,000
合计	100.00%	41,000	100.00%	102,500

#### 2、增资士兰集昕

大基金出资 2 亿元人民币，增资后的集华投资出资 6 亿元人民币，共同增资杭州士兰集昕微电子有限公司。本次增资每注册资本 1 元对应的增资款为 1.13800623 元，故增资款 8 亿元认缴注册资本 702,983,849 元。增资后士兰集昕的注册资本将增加至 1,962,379,412 元。

其中，大基金以货币出资 2 亿元，认缴注册资本 175,745,962 元，本次认缴

注册资本占增资后士兰集昕注册资本的 8.96%；集华投资以货币出资 6 亿元，认缴注册资本 527,237,887 元，本次认缴注册资本占增资后士兰集昕注册资本的 26.87%。本次出资溢价部分将计入士兰集昕的资本公积。

增资完成后，士兰集昕的股权结构如下所示：

股东名称	增资完成前的持股比例	增资完成前的出资额 (元)	增资完成后的持股比例	增资完成后的出资额 (元)
杭州士兰微电子股份有限公司	9.80%	123,454,935	6.29%	123,454,935
杭州士兰集成电路有限公司	5.74%	72,303,290	3.68%	72,303,290
杭州高新科技创业服务有限公司	20.94%	263,637,338	13.44%	263,637,338
杭州集华投资有限公司	31.76%	400,000,000	47.25%	927,237,887
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	31.76%	400,000,000	29.34%	575,745,962
<b>合计</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,259,395,563</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,962,379,412</b>

## (二) 投资各方的基本情况

### 1、国家集成电路产业投资基金股份有限公司

(1) 公司名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司

(2) 成立时间：2014 年 9 月 26 日

(3) 注册地址：北京市市辖区经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 718 室

(4) 注册资本：9,872,000 万元

(5) 法定代表人：王占甫

(6) 公司类型：股份有限公司（非上市）

(7) 经营范围：股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询

(8) 股东情况：财政部（25.95%）；国开金融有限责任公司（23.07%）；中国烟草总公司（14.42%）；北京亦庄国际投资发展有限公司（7.21%）；中国移动通信集团有限公司（7.21%）；其他股东合计 22.14%。

### 2、杭州集华投资有限公司

(1) 公司名称：杭州集华投资有限公司

- (2) 成立时间：2015 年 12 月 4 日
- (3) 注册地址：杭州市西湖区黄姑山路 4 号 9 号楼 1 楼
- (4) 注册资本：41,000 万元
- (5) 法定代表人：陈向东
- (6) 经营范围：服务：实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）
- (7) 股东情况：本公司持有集华投资 51.22% 的股权，大基金持有集华投资 48.78% 的股权。
- (8) 待本次共同投资事项完成后，集华投资的注册资本将由 41,000 万元增加至 102,500 万元。

### 三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：杭州士兰集昕微电子有限公司
- 2、成立时间：2015 年 11 月 4 日
- 3、注册地址：浙江省杭州经济技术开发区 10 号大街（东）308 号 13 幢
- 4、注册资本：1,259,395,563 元
- 5、法定代表人：陈向东
- 6、经营范围：制造、销售：8 英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块；销售：8 英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块相关的原材料，机械设备及零配件、仪器仪表；8 英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块的技术开发、技术转让；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
- 7、现有股东情况：

序号	股东	认缴注册资本（元）	出资形式	持股比例
1	杭州士兰微电子股份有限公司	123,454,935	货币	9.80%
2	杭州士兰集成电路有限公司	72,303,290	货币	5.74%
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	400,000,000	货币	31.76%
4	杭州集华投资有限公司	400,000,000	货币	31.76%
5	杭州高新科技创业服务有限公司	263,637,338	货币	20.94%
合计		1,259,395,563		100%

以上所有股东的出资均已全部如实到位。

- 8、截至 2018 年 12 月 31 日，士兰集昕经审计的总资产为 201,954.16 万元，负债为 94,256.98 万元，净资产为 107,697.18 万元。2018 年营业收入为

35,099.74 万元，净利润为-13,901.00 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，士兰集昕未经审计的总资产为 211,862 万元，负债为 112,270 万元，净资产为 99,592 万元。2019 年上半年营业收入为 21,923 万元，净利润为-8,105 万元。

#### **四、投资事项对上市公司的影响**

如本次投资事项顺利实施，将有效调整公司的资产结构，为公司 8 吋集成电路芯片生产线的后续建设提供重要的资金保障，有利于加快公司 8 吋线的建设和运营，从而进一步提升公司制造工艺水平，增强公司盈利能力，提高综合竞争力。

#### **五、投资的风险分析及对策**

1、士兰集昕 8 吋线二期项目的建设周期约为五年，在逐步达产过程中容易受到市场外部环境变化等因素的影响，可能会对该项目效益的整体发挥产生不利影响。

对策：公司将尽快落实解决项目建设过程中出现的各种问题，尽量提前建成并争取早日达产。同时公司将不断加强内部管理，提升工艺技术水平，持续开发新产品，提高市场占有率，进一步拓展销售渠道，与国内外知名客户建立长期稳定的业务关系。

2、本项目工艺设备投资较大，设备采购价格对项目投资影响较大，多台主要工艺设备需从国外进口，因此汇率的不可预期或大幅变化对本项目实施会造成一定压力。

对策：公司将会对当前经济形势以及汇率变化趋势做理性分析及判断，做好前期设备调研、询价工作，把握时机签约采购。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日